

Karta techniczna

Easy Print /Sn96,5Ag3Cu0,5/

Opis:

Pasta przeznaczona do lutowania elementów w montażu powierzchniowym SMD.

Zalety:

- odporna na zjawisko kuleczkowania (mid chip solderballing),
- dobra przyczepność do elementów przez ponad 24 godziny od jej nałożenia,
- pasta oddaje wiernie kontury nawet przez 8 godzin ciągłego druku, co zapewnia jej przedłużony czas przydatności (stencil life),
- minimalne, bezbarwne, niekorozyjne pozostałości po lutowaniu (no clean), które dzięki swojej elastyczności ułatwiają przenikanie igieł testerów,
- pasta posiada dużą wierność odtwarzania szczegółów (fine pitch),
- możliwości druku z prędkością rakli do 150 mm/s.

Właściwości fizykochemiczne:

Właściwości	Wartość	Normy
Chemiczne		
Rodzaj spoiwa	Sn96,5Ag3Cu0,5	
Klasyfikacja topnika	REL - 0	J-STD - 004
Test chromatografii bibułowej na Cl	spełnia (REL - 0)	IPC TM 650
Fizyczne		
Gęstość	≈ 4,6 g/cm ³	IPC-TM 650T
Uziarnienie	25-45 μm	IPC-TM 650T
Kleistość	1,0 G/mm ² po 24h	IPC J-STD - 005
Przydatność do druku	ponad 8h	
Elektryczne		
SIR-IPC	> 2,6*10 ⁹ Ω, pomiar po 7 dniach	IPC J-STD 004 (85°C, w 85%)

Symbole:

SIR - Surface Insulation Resistance -oporność powierzchniowa rezystancji

IPC - J STD 004/ 005, IPC - TM650 - amerykańskie normy definiujące wymagania techniczne past i topników

Wymagania aplikacyjne:

Magazynowanie	Drukowanie	Lutowanie rozpltywowe	Mycie
<ul style="list-style-type: none"> przechowywać w temp. 3-7°C przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w pojemnikach szczelnie zamkniętych najlepsza (optymalna) temp. nakładania pasty: 23-26°C temperatura max. nakładania pasty 28°C aby uniknąć zmian właściwości smarnych pasty nie należy łączyć zużytej ze świeżą aby nie dopuścić do kondensacji wilgoci i uzyskać odpowiednią właściwość pasty przed jej otwarciem należy doprowadzić ją do temperatury otoczenia przez okres kilku godzin 	<ul style="list-style-type: none"> szablony cięte laserem lub elektroformowane: 100 µm dla rasta = 0,4mm 150 µm dla rasta > 0,5 mm zalecane rakle metalowe szybkość rakli w drukarce: 25- 150 mm/sek nacisk na rakle: 1.5-3N na cm długości ilość pasty na szablonie: watek grubości 15-20 mm rolujący się przed raklą 	<ul style="list-style-type: none"> możliwe są wszystkie sposoby lutowania (w atmosferze normalnej i w azocie) podgrzewanie wstępne: stały wzrost 1-2,0°C/s aż do temp. 145-160°C lub max. 210-220°C dla wersji bez plateau faza plateau (jedynie dla pakietów o dużym zagęszczeniu elementami o różnej masie) 145-160°C przez 60-90 s lutowanie - faza rozpltywu: 30-90 s powyżej 180°C chłodzenie: gradient: 1-2°C/s 	<ul style="list-style-type: none"> pasta jako „no clean” nie wymaga zasadniczo mycia jeżeli mycie jest niezbędne polecamy Zmywacz PCB alkoholowy.

Opakowania:

Pojemność	Rodzaj opakowania	Opakowanie zbiorcze	Kod artykułu
1,4 ml	strzykawka	5	ART.AGT-028
20 g	kartusz	1	ART.AGT-029
40 g	kartusz	1	ART.AGT-030
250 g	plastikowe pudełko	1	ART.AGT-026
500 g	plastikowe pudełko	1	ART.AGT-032

Procedura lutowania dla profilu Nr 1

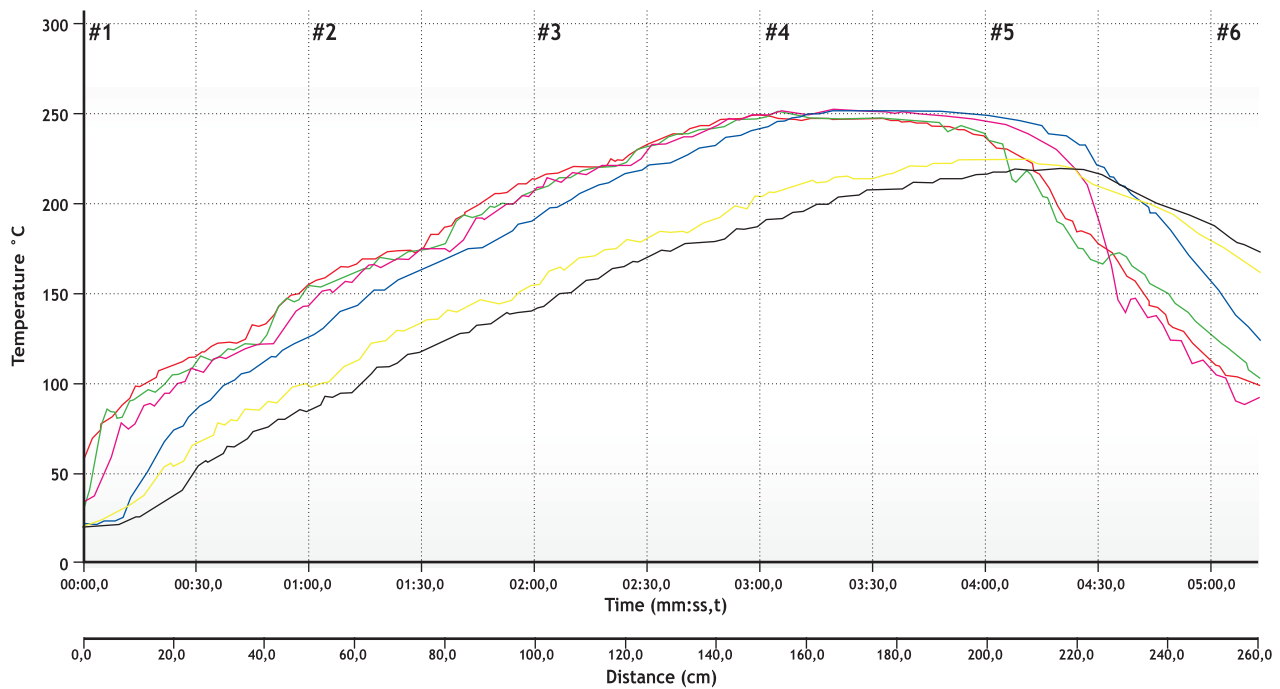
Zone	1T	2T	3T	4T	5T
Setpoint °C	150	200	250	275	255
Actual °C	150	200	249	273	254

Blower Power	80	80	80
Setpoint %			

Zone	1B	2B	3B	4B	5B
Setpoint °C	150	200	250	275	255
Actual °C	150	200	247	273	254

Start Run	On	Edge Conveyor	cm	Center Support	cm	Conveyor	cm
Heat	On	Setpoint	29.00	Setpoint	14.00	Setpoint	45.00

Profil lutowania Nr 1 użyty w badaniach



Reflow Results

Probe	Positive Slope (°C/sec)	Positive Slope Time (mm:ss,t)	Rise Time (150,0 - 190,0 °C) (mm:ss,t)	Time Above Liquidus (217,0 °C) (mm:ss,t)	Peak Temperature (°C)	Delta T (°C)	Negative Slope (°C/sec)
#1 (°C)	4,50	00:00,0	00:43,0	02:08,0	249,0		-3,25
#2 (°C)	7,20	00:03,0	00:42,0	01:55,0	250,5		-3,14
#3 (°C)	3,68	00:16,0	00:43,0	02:06,0	252,0	● 32,0	-2,74
#4 (°C)	2,37	00:28,0	00:53,0	00:29,0	220,0	○	-1,37
#5 (°C)	2,36	00:18,0	00:50,0	00:49,0	224,5		-1,49
#6 (°C)	4,72	00:06,0	00:41,0	02:10,0	252,0	●	-7,61